



中华人民共和国国家标准

GB/T 4722—92

印制电路用覆铜箔层压板试验方法

Test methods for copper-clad laminated
sheets for printed circuits

1992-07-08 发布

1993-04-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
印制电路用覆铜箔层压板试验方法
GB/T 4722—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1992年12月第一版 2006年6月电子版制作

*

书号: 155066·1-23441

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

GB/T 4722—92

印制电路用覆铜箔层压板试验方法

代替 GB 4722—84

Test methods for copper-clad laminated sheets for printed circuits

本标准参照采用国际标准 IEC 249-1(1982 年)《印制电路用覆金属箔基材 第一部分:试验方法》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了印制电路用覆铜箔层压板的电气、机械和其他性能的试验方法。
本标准适用于各种印制电路用覆铜箔层压板(以下简称覆箔板)性能的测试。

2 引用标准

- GB 1409 固体电工绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数
- GB 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ca:恒定湿热试验方法
- GB 2423.28 电工电子产品基本环境试验规程 试验 T:锡焊
- GB 4207 固体绝缘材料在潮湿条件下相比起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法
- GB 2036 印制电路名词术语和定义

第一篇 一般要求

3 试样

3.1 试样的制备

3.1.1 清洗与印制测试图形

3.1.1.1 如果需要制作试验图形,将覆箔板加工成所需尺寸。受试覆箔板的铜箔面应用水调和的磨料粉(如浮石粉)进行清洗(如有必要再加磷酸钠清洗),直至整个铜箔面上形成一个不破裂的水膜,再在 10%盐酸溶液中浸一次,用水清洗后擦净其表面水分并烘干。

3.1.1.2 经上述清洗处理后的覆箔板,用能得到规定精度的方法,将测试图形印在铜箔面上。

3.1.2 蚀刻方法

3.1.2.1 无论是做测试图形,还是去掉整个铜箔,都需用适当的蚀刻方法进行蚀刻(如氯化铜等)。在供需双方有争议时,则用喷淋法,喷射密度为 $1.32 \sim 1.41 \text{ g/cm}^3$ 的三氯化铁水溶液进行蚀刻,溶液温度不超过 37°C 。蚀刻时间以得到清晰的测试图形为度,最长蚀刻时间不得超过表 1 规定。